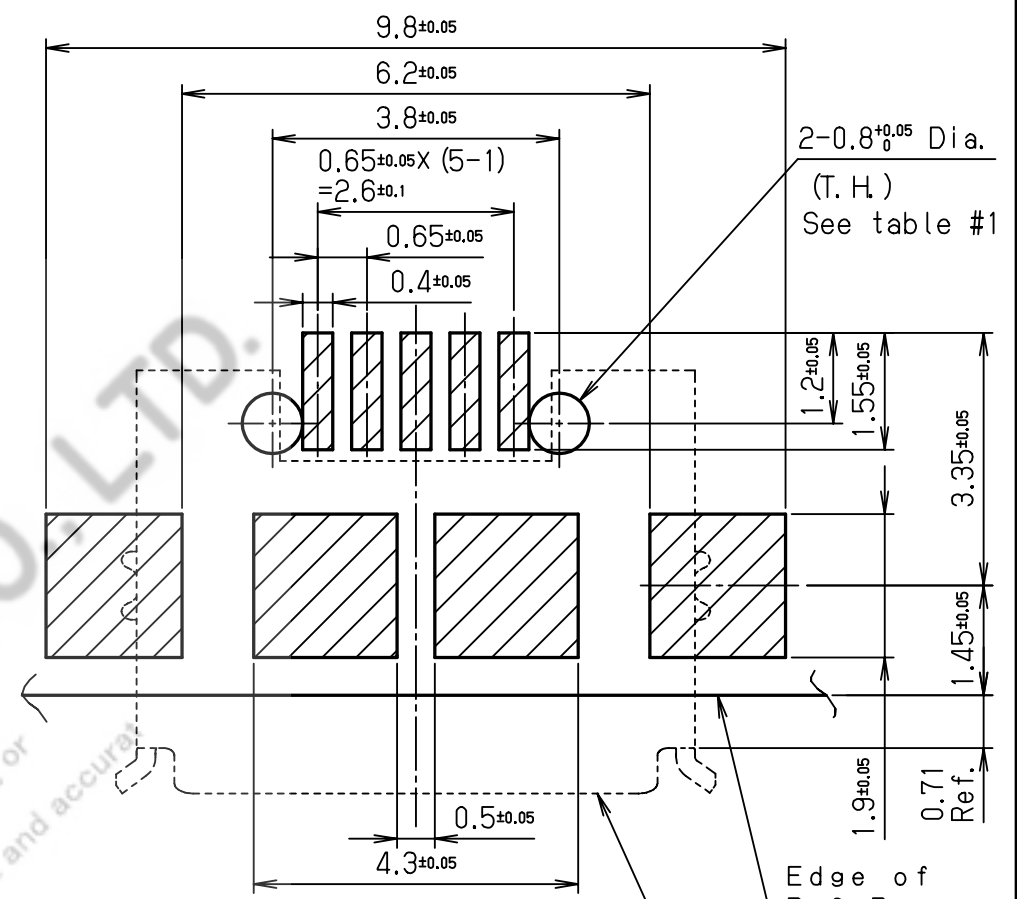
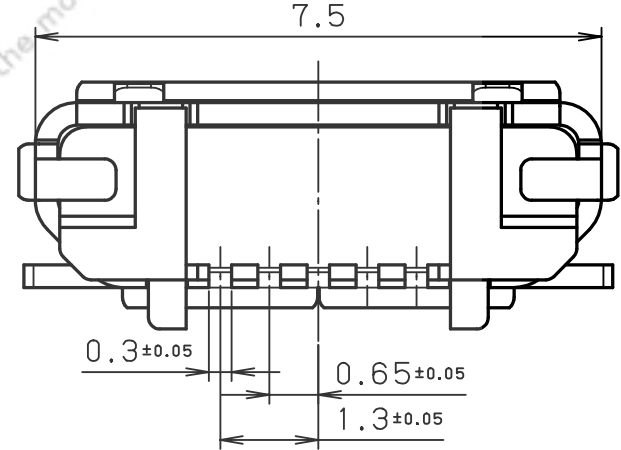
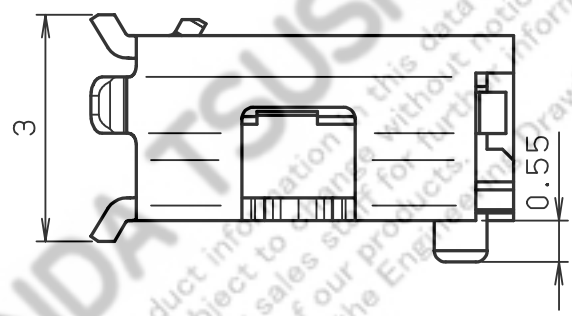
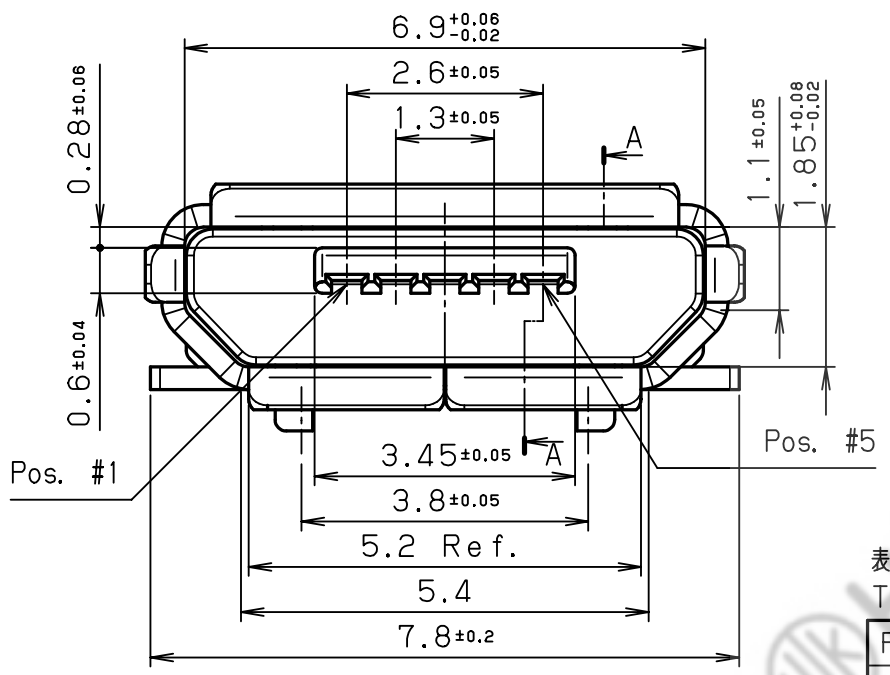


A-A断面  
Section A-A



推奨基板レイアウト  
Recommended P.C.B. layout

Edge of P.C.B.  
Connector outline



RoHS compliant

注1. コンタクト処理  
接触部: Gold 0.76µm min.  
半田付け部: Gold 0.07 min.  
下地めっき: Nickel  
2. シェル処理: Nickel 1µm min.

Note1. Contact plating  
Contact area: Gold 0.76µm min.  
Termination area: Gold 0.07µm min.  
Underplating: Nickel  
2. Shell plating: Nickel 1µm min.

表1.  
Table 1

Part no. : QZF-MC5LMYG1-B+	
注. 基板位置決め用穴は、必要ありません。 Note: Arrangement of two through holes in P.C.B. layout is not necessary.	
Part no. : QZF-MC5LMYG1B-B+	

3	シェル Shell	ステンレス鋼 Stainless steel	1	注2参照 See note #2	
2	絶縁体 Insulator	耐熱性樹脂 High-temperature resin	1		UL94V-0 黒色 UL94V-0 Black
1	コンタクト Contact	銅合金 Copper alloy	5	注1参照 See note #1	

改版 LTR.	年月日 DATE	変更者 BY	変更内容 REV. DESCRIPT	番号 No.	部品名 PART NAME	材質 MATERIAL	個数 QTY	処理 FINISH	備考 NOTE
	08.27 Aug 27 (2007)		5/1						
製図 DR.				設計 DE.		検図 CHK.		承認 APP.	
H. SATO		H. SATO		T. SOGO		T. SATO		K. KASHIO	
製番 PART NO.						QZF-MC5LMYG1 ( ) -B+		REV.	